

杭州士兰微电子股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈
- 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 15,000 万元到 19,000 万元；预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 18,400 万元到 22,400 万元。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 15,000 万元到 19,000 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 18,400 万元到 22,400 万元，与上年同期相比，将增加 12,510 万元到 16,510 万元，同比增加 212.39%到 280.31%。

（三）本期预计业绩未经注册会计师审计。

二、 上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-3,578.58 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,889.92 万元。

（二）每股收益：-0.02 元。

三、 本期业绩变动的主要原因

（一）报告期内，面对市场竞争加剧的压力，公司通过持续推出富有竞争力

的产品，持续加大对大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的拓展力度，加快产品结构调整的步伐。在电源管理芯片、IGBT 器件、IPM 智能功率模块、PIM 功率模块、碳化硅 MOSFET 器件、超结 MOSFET 器件、MEMS 传感器、MCU 电路、SOC 电路、快恢复管、TVS 管、稳压管等产品出货量增长的带动下，公司总体营收保持了较快的增长势头。

（二）报告期内，公司子公司士兰集成 5、6 吋芯片生产线、子公司士兰集昕 8 吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科 12 吋芯片生产线均实现满负荷生产。公司已安排技改资金进一步提升 8 吋线 MEMS 芯片产能、12 吋线 IGBT 芯片和模拟电路芯片产能。公司预计 2025 年 5、6、8、12 吋芯片生产线将继续保持较高的产出水平。

报告期内，公司子公司成都士兰、成都集佳功率模块和功率器件封装生产线实现了满负荷生产，公司根据市场需求已安排了多轮产能扩充项目。

报告期内，公司加快子公司士兰明镓 6 吋 SiC 芯片生产线产能建设，目前士兰明镓已具备月产 0.9 万片 SiC MOSFET 芯片的生产能力。公司已完成了第三代、第四代平面栅 SiC MOSFET 芯片的开发，性能指标达到业内同类器件结构的先进水平。基于公司 II 代 SiC MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模块，已实现向下游汽车用户批量供货；基于公司 IV 代 SiC MOSFET 芯片生产的电动汽车主电机驱动模块已在客户端验证，预计 2025 年实现批量供货。

报告期内，公司在厦门加快建设一条以 SiC MOSFET 为主要产品的 8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线，项目一期投资规模 70 亿元，规划产能 3.5 万片/月，预计 2025 年年底实现初步通线。

报告期内，公司完成了杭州、厦门两地 LED 芯片生产线的整合。整合后的 LED 芯片生产线的生产能力已达到 14-15 万片/月。公司通过对 LED 芯片生产线技术改造，较大提升了 mini-LED 芯片的生产能力。

（三）报告期内，公司在积极扩大芯片生产线和封装生产线产出能力的同时，持续开展了各主要环节成本费用控制、管理效率提升等活动，目前已取得了积极成效。四季度，公司产品综合毛利率较三季度已有所回升。随着上述活动的持续深入进行，预计 2025 年公司产品综合毛利率水平将进一步改善。

（四）经过二十多年的发展，公司已成为目前国内领先的 IDM 公司。作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，在外部经济周期变化的压力下，也

会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但是相较于轻资产型的 Fabless 设计公司，公司在特色工艺和产品的研发上具有更突出的竞争优势：实现了特色工艺技术与产品研发的紧密互动，以及集成电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、光电器件和第三代化合物半导体芯片的协同发展；公司依托 IDM 模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，加快提升产品品质、加强控制成本，向客户提供高质量、高性价比的产品与服务，可满足下游整机（整车）用户多样化需求，具有较强的市场竞争能力。2024 年全年，公司电路和器件成品的销售收入中，已有超过 75% 的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。当前，在国家政策持续支持，以及下游电动汽车、新能源、算力和通讯等行业快速发展、芯片国产替代进程明显加快的大背景下，士兰微电子迎来了较快发展的新阶段。士兰微电子将持续推动满足车规级和工业级要求的器件和电路在各生产线上量，持续推动士兰微整体营收的较快成长和经营效益的提升。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日